

溶融時の流動性を活発化させ、ボイドを排出

Increases fluidity of solder in a melted state to eliminate voids

特長

- 強力なはんだ濡れ性が、はんだ溶融時の流動性を活発化
- Cu-OSP基板でもはんだ濡れ性が良好で、ボイド発生を抑制
- 強力な濡れ性を有しても、絶縁信頼性は充分確保



仕様

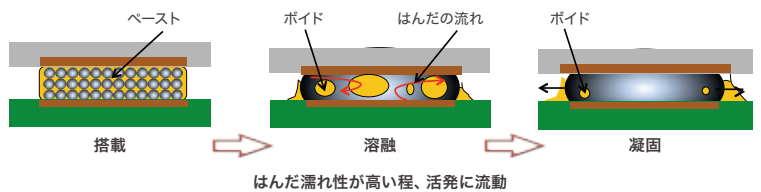
● 放熱性を阻害するボイドは大敵

濡れ性に劣る Cu-OSP 品はボイドが多い



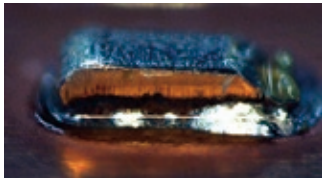
● ボイド発生メカニズム

LGA や Die など、逃げ場の少ない端子にボイドは多い



● 強力なはんだ濡れ性を実現

はんだ付けが困難な、Cu母材リード破断面にも充分な濡れを確保
従来製品



M705-NX001

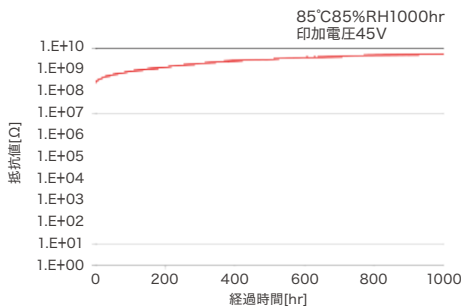


● 溶融温度領域の最適プロファイルとNX001でボイドを激減

| | 従来品 | | N705-NX001 |
|----------------|--------|---------|------------|
| | Auめっき品 | Cu-OSP品 | Cu-OSP品 |
| パワー トランジスター | | | |
| QFN 底面電極 | | | |

Cu-OSP基板でもボイドを大幅に低減

● 強力なはんだ濡れ性を有するが、高絶縁性を維持



最適推奨プロファイル

220°C時間: 40~60Sec.

